

# 关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2024 年度提质增效重回报》行动方案。结合 2024 年半年度报告，对方案评估具体如下：

## 一、在“聚焦 MCU 研发新品，持续提升产品竞争力”方面

2024 年上半年，加强募投项目管理，完善募集资金使用和归集规则，募集资金使用得到提速。公司研发聚焦 MCU 立项，围绕募投项目，共新立项研发项目 15 件，其中涉及消费电子 4 件、涉及家电 5 件、涉及工业控制（无刷电机）3 件、涉及汽车电子 3 件，上述研发项目完成后，将阶段性的推进募投项目进展，有效拓宽产品系列，丰富产品资源，同时公司针对现有量产产品持续优化成本，提高产品性能和品质，从而提高公司产品竞争力。上半年投入研发 5,956.06 万元，出货量约 11 亿颗，实现营收 42,868.47 万元，毛利率回归到 30%，实现净利润 4,302.22 万元。

## 二、在“加强研发人才发展战略，提升科技创新能力”方面

持续校园招聘，通过招聘优秀应届毕业生 12 人，为研发人才队伍补充新鲜血液，加强人才梯队建设，确保“老中青”人才结构合理，保持长期有序发展。

在与高校联合方面，与电子科大的联合研发项目得到有效推进，首期委托研发资金完成拨付，通过项目合作，加强了公司研发人员与高校科研人员的交流与合作。

启动股权激励咨询项目，对当前股权激励计划进行评估，对未来出台更科学更合理的激励计划进行策划，让研发人才能共享公司发展红利，与公司共发展。

公司注重知识总结，尊重研发成果，保护知识产权，今年上半年累计申请发明专利 2 项，获得发明专利批准 3 项；申请实用新型专利 2 项，获得实用新型专利批准 0 项；申请集成电路布图 50 项，获得集成电路布图批准 33 项。

## 三、在“优化财务管理，加速资金回笼”方面

积极推行信用担保制度，财务部门根据客户资产、现金流、经营规模、实现利税情况、历史信用等情况，决定客户的信用额度和账期，推进客户实控人对信用额度进行担保，减少信用风险；每周跟进各客户的应收账款情况，通报提醒销售部门加大对应收账款的催收力度；严格落实逾期与信用额度、赊销挂钩制度，对一旦出现逾期的客户，取消赊销，同时不再发货。

2024 年，公司将继续加强现金管理，持续推进使用暂时闲置自有资金及募集资金购买低风险、高流动性及具有一定收益性的银行理财产品，以保障公司现金流充裕，实现安全与收益的平衡。

#### **四、在“深化公司治理，保障规范运作”方面**

加强对“关键少数”培训力度，董秘办将最新监管政策、监管案例汇编转发，提高“关键少数”履职意识和履职能力；厘清权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分工，进一步规范三会运作，不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

2024 年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益；提高“关键少数”规范意识和履职能力，建立管理层与股东利益共享机制。同时将继续完善企业管理模式，完善 BU 制度，基于 IPD 流程建立产品开发体系，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，推进职业经理人负责制，激发职业经理人的激情与才智，推动公司的长期稳健发展。

#### **五、在“提升信披质量，加强投资者交流”方面**

公司始终高度重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等公司重大信息；也积极通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通。

2023 年年报披露后，公司注重和投资者保持交流，组织了由公司董事长、总经理和独立董事参加的集体业绩说明会；除此以外，上半年，公司共参加各类策略会、线上线下调研活动共 15 场，接待调研机构共 142 家。

## 六、在“共享发展成果，注重投资者回报”方面

在 2023 年度公司经营出现亏损的情况，考虑到公司历史滚存利润、投资者的回报需求和公司的长远发展需要，公司修订了《股东分红规划》，并于 2024 年 6 月向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利总额为 99,898,750.00 元（含税），让全体股东共享公司发展成果。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，2023 年 8 月，公司公布了回购股份方案，截止 2024 年 8 月回购期间结束，公司累计回购股份 1,506,639 股，回购资金总额 3000 余万元。

本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日